

证券代码：603061

证券简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场访谈 ☐ 其他 ☐ 线上分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☒ 路演活动 ☐ 线上调研
参与单位名称	特定对象调研、路演活动：南方基金、太平基金、富国基金、华安基金、国联安基金、浦银安盛基金、西部利得基金、人保资产、太平资产、鹤禧投资、彤源投资、中泰证券、光大证券（以上排名不分先后）； 业绩说明会：参与业绩说明会的投资者。
时间	2025 年 4 月 28 日至 4 月 29 日
地点	特定对象调研、路演活动：上海市浦东新区富城路 33 号、上海市浦东新区世纪大道 1196 号； 业绩说明会：上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）。
上市公司接待人员姓名	特定对象调研、路演活动：副总经理兼董事会秘书刘海龙先生； 业绩说明会：董事长、总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生、财务总监黄洁女士。
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍主要内容 金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、

	欧美等全球市场。 公司自成立以来，一直坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。 公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。 二、公司 2025 年第一季度经营情况介绍 受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响，公司 2025 年第一季度实现营业收入 1.29 亿元，较上年同期增长 45.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,565.85 万元，较上年同期增长 72.29%。2025 年第一季度末，公司总资产为 16.64 亿元，较 2024 年末增长 4.11%；2025 年第一季度末，公司归属于上市公司股东的净资产为 13.48 亿元，较 2024 年末增长 2.39%。 公司持续加大研发投入，募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”按照既定计划有序推进，建成后将进一步增加公司研发及制造等综合竞争力。 市场推广方面，公司持续扩大现有市场，逐步建立起规模优势。在新开发的客户市场，依靠自身技术优势，针对客户的定制化需求，提供更优质的服务，逐步形成品牌效应，获得新的发展。 三、调研问答 1、问：本期业绩增长是什么原因？ 答：2025 年第一季度营业收入较上年同期增长 45.21%，净利润较上年同期增长 72.29%，主要系公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素所致。
--	---

	2、问：客户一般多久下订单？ 答：一般情况下，客户会与公司进行持续性的常态化沟通，对公司产品的技术指标及交货周期等进行了解。对于量产机型及标准选配功能，公司具有快速交货能力。基于这种情况，客户通常会在需求相对确定时下单。 3、问：一般的测试分选机能在客户端使用多长时间？ 答：公司的设备是半导体专用设备，设备在正常使用和维护状态下，可以长期使用。 4、问：请问公司人员方面较以前年度是否有变化？ 答：公司员工总数无较大变化。目前公司管理体系仍相对灵活，未来将结合生产经营、研发进展、客户端需求等实际情况进行人员规划。 三、业绩说明会问答 1、问：公司本期盈利水平如何？ 答：受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响，公司 2025 年第一季度实现营业收入 1.29 亿元，较上年同期增长 45.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,565.85 万元，较上年同期增长 72.29%。 2、请问公司如何鼓励科研人员创新？在激励制度方面做了哪些工作？能否简单介绍一下？谢谢 答：公司通过数字化人才管理与动态绩效考核，持续加强人才培养。通过构建短期薪酬及中长期激励的复合薪酬体系，重点强化研发人才储备及培养，为公司战略目标提供持续人才动能，促进公司的持续发展。 3、请问公司未来的分红计划和派息政策？ 答：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和未来发展战略的
--	--

	实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。 4、问：公司之后的盈利有什么增长点？ 答：公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，集成电路测试分选机属于集成电路专用设备领域的测试设备。公司产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为EXCEED系列、SUMMIT系列等系列产品。未来，公司发展的方向主要为三温、更多工位、更多产品应用的测试分选机，以及更多样化的上下料解决方案，以更高效、更稳定、更高精度、更多功能的测试分选机，满足更多类型客户的测试分选需求。与此同时，公司将不断提升内部运营效率，通过优化生产流程、加强供应链管理、合理控制费用支出等方式，在确保产品质量和技术竞争力的前提下，努力降低生产成本，提高盈利水平。 5、请问公司对未来的市场份额及盈利情况如何预测，谢谢！ 答：公司的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。公司的产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。 公司将继续加强市场开拓力度，同时持续加大研发力度，持续升级和迭代公司产品。与此同时，公司也将不断提升内部运营效率，提高盈利能力。 6、问：你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 答：受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响，公司 2025 年第一季度实现了较好的增长，公司 2025 年第一季度实现营业收入 1.29 亿元，较上年同期增长 45.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,565.85 万元，较上年同期增长 72.29%。 金海通自 2012 年成立以来，一直深耕集成电路测试分选机领域，公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好。产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。
--	--

	公司将持续加大研发，持续升级和迭代公司产品。 7、问：行业以后的发展前景怎样？ 答：未来，随着集成电路产业进一步发展，为确保产品质量、生产效率和生产稳定性，半导体测试分选设备企业需要与集成电路设计企业、封装测试企业等经过长时间的协作、磨合，提供符合集成电路产品测试分选需求、客户使用习惯和生产标准等的测试分选方案，产业链协同效应将构筑行业新壁垒。同时，测试任务的复杂性将对测试分选机设备提出更高的要求。 金海通自 2012 年成立以来，一直深耕集成电路测试分选机领域，公司产品技术指标已达到同类产品的国际先进水平。公司将继续保持以技术为核心的策略，进一步扩大现有市场，依靠自身技术优势，针对客户的测试分选需求，提供更优质的服务，获得新的发展。
附件清单 (如有)	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2025 年 4 月 30 日